

檔 號：  
保存年限：

## 財團法人工業技術研究院 函

地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號  
承辦人：廖盈婷  
電 話：03-5914539  
電子信箱：emily.liao@itri.org.tw

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國108年06月20日  
發文字號：工研電字第1080010842號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (1080010842A00\_ATTACH1.docx)

主旨：第十屆軟性與印製電子國際會議(The International Conference on Flexible and Printed Electronics, ICFPE)訂於2019年10月23日至25日舉辦，徵稿已正式開跑，敬請轉知 貴校師生踴躍參加投稿，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、軟性與印製電子國際會議(The International Conference on Flexible and Printed Electronics, ICFPE)為韓國、日本、台灣、大陸輪流主辦的國際研討會，今年第十屆ICFPE謹訂於2019年10月23日至25日假台北南港展覽1館舉辦，函請 貴校協助於網站公告徵稿活動訊息，廣邀相關領域師生及先進專家共襄盛舉。
- 二、活動名稱：ICFPE 2019第十屆軟性與印製電子國際會議。
- 三、日期：2019年10月23日至25日
- 四、地點：台北市南港區經貿二路1號 (Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, Taiwan)
- 五、投稿截稿日：7月7日前須於線上提交摘要。2019年8月8日



大會將以email通知投稿者審查結果。投稿者需於10月01日以前報名註冊以享有早鳥報名優惠。投稿網址：  
<https://expo.itri.org.tw/2019ICFPE/Submission>

- 六、凡投稿者，皆有機會獲選為最佳論文得獎者並將於會議期間進行頒獎。
- 七、ICFPE 2019大會網址：<https://expo.itri.org.tw/2019ICFPE>
- 八、今年ICFPE 2019除與 IMPACT (14th International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology) 合作舉辦外，並於1樓的TPCA Show 2019(台灣電路板產業國際展覽會)設有專屬的軟電展覽專區，活動內容精采可期。
- 九、惠請 貴會協助公告活動消息，並將活動資訊轉知相關領域會員與先進專家。檢附ICFPE 2019徵稿內容，敬請查收參閱。
- 十、如需進一步詢問或有投稿相關問題，請聯絡大會秘書處：  
廖盈婷 Emily Liao Conference Secretariat of ICFPE  
2019TEL : +886-3-591-4539 Email : [icfpe@itri.org.tw](mailto:icfpe@itri.org.tw)

正本：國立交通大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺北科技大學、國立臺灣海洋大學、國立臺灣師範大學、國立陽明大學、大同大學、國立中央大學、國防大學、長庚大學、元智大學、萬能科技大學、國立聯合大學、明新科技大學、國立中興大學、逢甲大學、中山醫學大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、明道大學、建國科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立中正大學、國立嘉義大學、吳鳳科技大學、國立成功大學、國立臺南大學、南臺科技大學、崑山科技大學、國立中山大學、國立高雄科技大學、國立高雄師範大學、國立屏東大學、國立東華大學、大葉大學、中原大學、國立臺北大學、國立高雄大學、國立臺灣科技大學、國立屏東科技大學、國立勤益科技大學、東海大學、輔仁大學、東吳大學、淡江大學、世新大學、銘傳大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、樹德科技大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、僑光科技大學、南開科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、義守大學

副本：

